

## 杭州士兰微电子股份有限公司

### 关于公司为士兰集科提供担保事项的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“士兰微”或“上市公司”）第七届董事会第二十六次会议于 2021 年 9 月 29 日以通讯的方式召开。该次董事会审议并通过了《关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为参股子公司厦门士兰集科微电子有限公司向国家开发银行厦门市分行申请的 2.5 亿元人民币 3 年期流动资金贷款提供全额连带责任保证担保。具体内容请详见公司于 2021 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为士兰集科提供担保暨关联交易的公告》，公告编号：临 2021-059。

公司控股股东杭州士兰控股有限公司为了支持士兰微的发展，对士兰微向士兰集科提供的全额连带责任保证担保进行反担保。本公司已收到其出具的担保函，担保函的主要内容如下：

“鉴于杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“士兰微”或“上市公司”）为其参股子公司厦门士兰集科微电子有限公司（以下简称“士兰集科”）向国家开发银行厦门市分行申请的 2.5 亿元人民币 3 年期流动资金贷款提供了全额连带责任保证担保。

为支持上市公司发展，降低士兰微在该担保事项中的担保风险，本公司为士兰微向士兰集科提供的全额连带责任保证担保提供反担保，以切实保障上市公司的利益。

本函件在士兰微为士兰集科该贷款担保事项存续期间持续有效。”

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 8 日